Capacita' MOS in condizioni di non equilibrio: Applicazione di potenziali esterni alla giunzione → Livello di Fermi non costante

Situazione simile a quella delle giunzioni *pn* o Schottky, ma con una fondamentale differenza:
l'ossido *impedisce* il passaggio di corrente

→ La giunzione MOS non e' un diodo come gli altri, piuttosto una *capacita'* sui generis: controllo esterno, via gate, della concentrazione di cariche libere in un canale *p* o *n* consente l'operazione di un dispositivo a 3 terminali, il MOSFET, che ha proprieta' generali simili a quelle di un BJT, ma che e' molto piu' vantaggioso sotto quasi tutti i profili

Regime di **svuotamento**: $V_G \pm va$, valori piccoli ~ 0

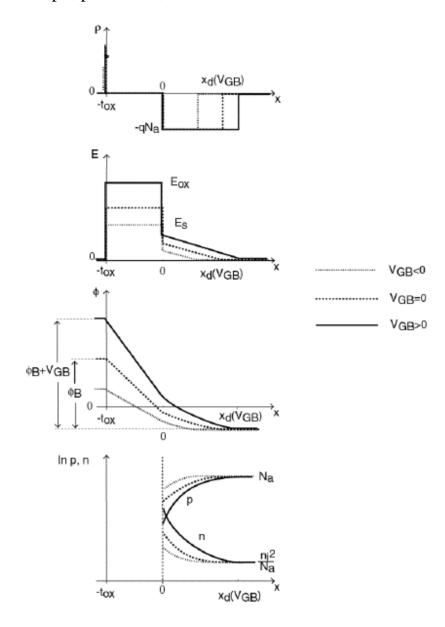
 $V_G < 0 \rightarrow$ Attrazione lacune cresce

→ Strato di svuotamento si restringe

 $V_G > 0 \rightarrow$ Attrazione lacune diminuisce

→ Strato di svuotamento si allarga

Conseguenze su campo, potenziale, concentrazioni:



Fenomeni interessanti per tensioni piu' grandi

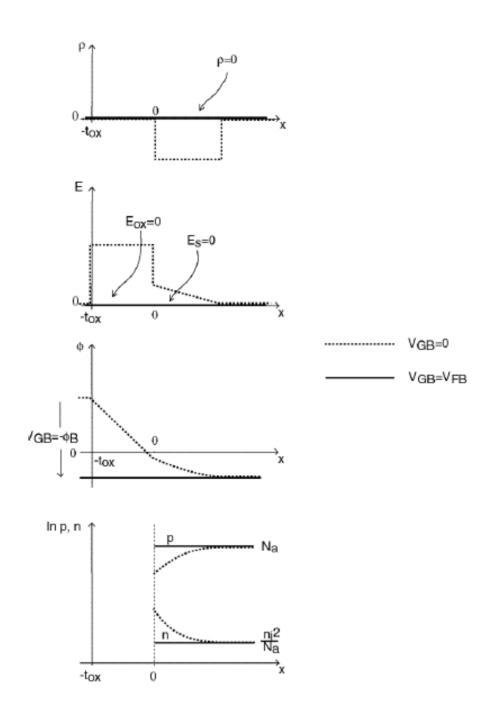
1. Tensioni – ve

Tensione – va caratteristica V_{FB} :

Strato di svuotamento scomparso

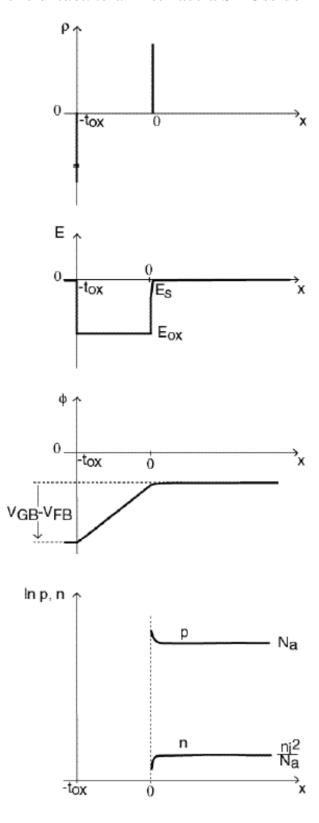
 \rightarrow Banda piatta \equiv Flatband

$$V_{\scriptscriptstyle FB} = -\phi_{\scriptscriptstyle B}$$



Regime di **accumulazione**: $V_G < V_{FB} < 0$

ightarrow Accumulazione di lacune all'interfaccia S - Ossido



2. Tensioni +ve

$$0 < V_G < V_T$$

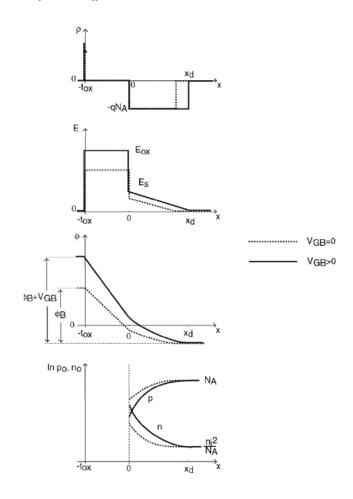
Espansione dello strato di svuotamento all'aumentare di ${\cal V}_{\!\scriptscriptstyle G}$ Situazione di quasi equilibrio:

Si applicano i risultati dello stato di equilibrio con $\phi_{\scriptscriptstyle B} \to \phi_{\scriptscriptstyle B} + V_{\scriptscriptstyle G}$

Nessun passaggio di corrente attraverso lo strato di svuotamento:

Ossido = Isolante

$$\to J = 0 \to j_{\rm drift} = -j_{\rm diff}$$



Espansione non illimitata:

Nuovo fenomeno quando $V > V_T$

Tensione caratteristica di soglia V_T t.c. $n(0) = N_A$

→ Concentrazione elettroni = Densita' di carica spaziale +va

Calcolo di V_T :

$$n(0) = n_i e^{q\phi(0)/kT}$$

$$\rightarrow \phi(0)\Big|_{V_G=V_T} = \frac{kT}{q} \ln \frac{n(0)}{n_i}\Big|_{V_G=V_T} = \frac{kT}{q} \ln \frac{N_A}{n_i} = -\phi_p$$

Ddp. ai capi del semiconduttore quando $V_{\scriptscriptstyle G} = V_{\scriptscriptstyle T}$:

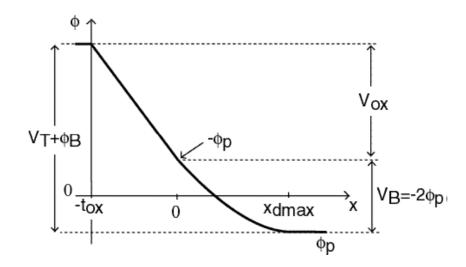
$$\rightarrow V_B(V_T) = -\phi_p - \phi_p = -2\phi_p$$

Ddp. ai capi dell'ossido per $V_G = V_T$:

$$V_B \left(V_G = V_T \right) = \frac{q N_A x_d^2}{2\varepsilon_s} = -2\phi_p$$

$$\rightarrow x_d (V_T) = x_{d \text{ max}} = \sqrt{\frac{2\varepsilon_s (-2\phi_p)}{qN_A}}$$

$$\rightarrow V_{ox}\left(V_{T}\right) = E_{ox}\left(V_{T}\right)t_{ox} = \frac{qN_{A}x_{d}\left(V_{T}\right)}{\varepsilon_{ox}} = \frac{1}{C_{ox}}\sqrt{2\varepsilon_{s}qN_{A}\left(-2\phi_{p}\right)}$$



Sommando tutto:

$$V_{T} + \phi_{B} = V_{B} (V_{T}) + V_{ox} (V_{T})$$

$$\rightarrow V_{T} + \phi_{B} = -2\phi_{p} + \frac{1}{C_{ox}} \sqrt{2\varepsilon_{s}qN_{A}(-2\phi_{p})}$$

$$\rightarrow V_{T} = -\phi_{B} - 2\phi_{p} + \frac{1}{C_{ox}} \sqrt{2\varepsilon_{s}qN_{A}(-2\phi_{p})}$$

$$\rightarrow V_{T} = V_{FB} - 2\phi_{p} + \frac{1}{C_{ox}} \sqrt{2\varepsilon_{s}qN_{A}(-2\phi_{p})}$$

 V_T aumenta con l'aumento del drogaggio

 V_T diminuisce con l'aumento della capacita'

 $\rightarrow V_{\scriptscriptstyle T}$ diminuisce con la diminuzione dello spessore dell'ossido

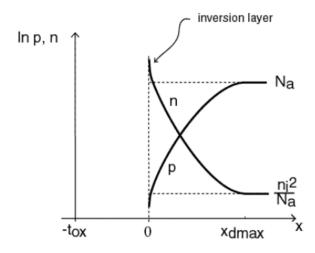
Valore di V_T rilevante per determinare i livelli logici nelle applicazioni digitali dei MOS

Questione molto importante relativamente al consumo di energia e alla dissipazione di potenza

Sopra tensione di soglia:

Regime di inversione

→ Accumulazione di *elettroni* all'interfaccia S-Ossido



Giunzione in condizioni $V_{\scriptscriptstyle G} > V_{\scriptscriptstyle T}$:

Concentrazione di elettroni nello strato di inversione controllata da ${\cal V}_{\scriptscriptstyle G}$

→ Concentrazione di cariche mobili controllata da tensione sul gate!

Riassunto:

